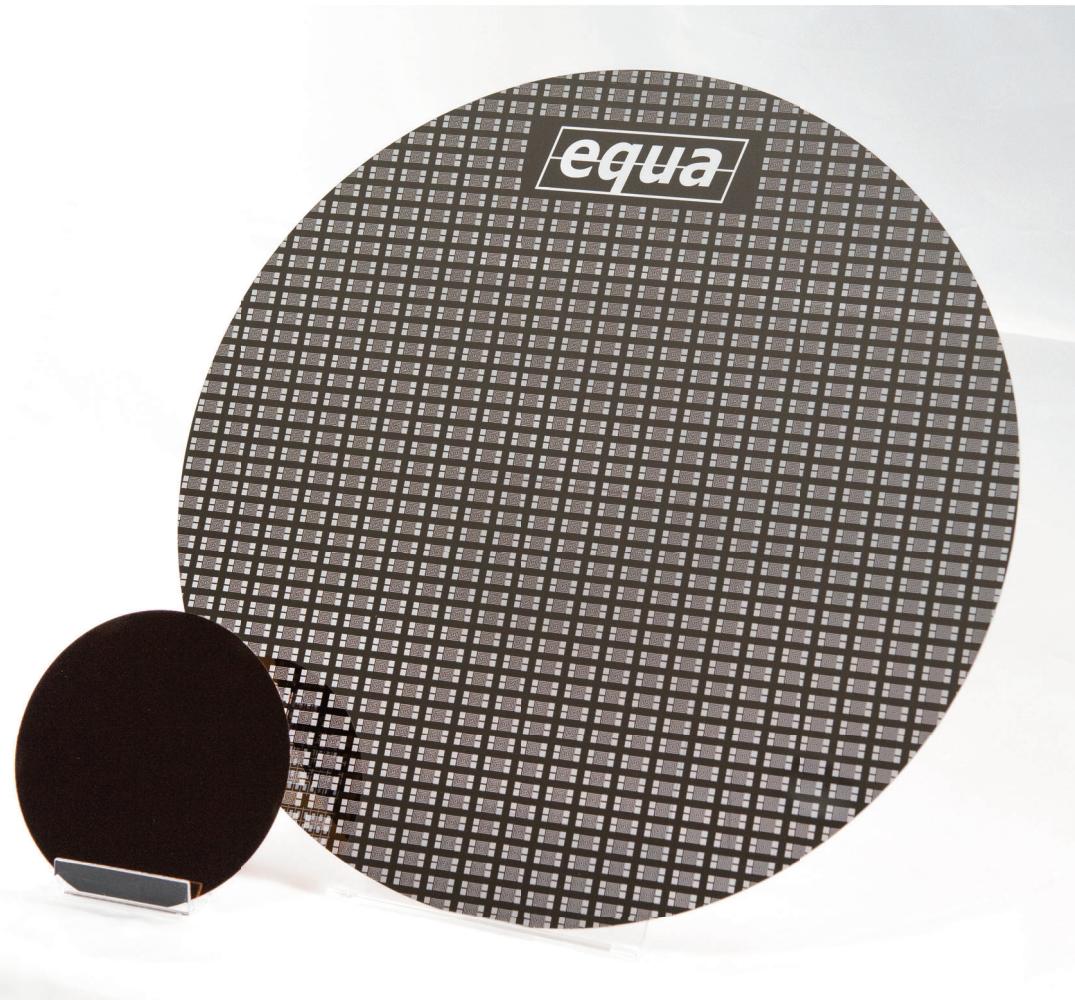


ウエハ

Wafer



エクアではウエハの加工製品を提供しています。

成膜加工はクロム膜以外にも絶縁膜 (SiN/SiO₂) やメタル膜 (Ti/Cu/SiN) など対応可能です。

またウエハ上にウェットエッチング、ドライエッチングによりパターン形成した製品を提供しています。

ベアウエハや化合物半導体用のウエハの提供も可能です。

シリコンウエハの用途は半導体デバイス、トランジスタ、ダイオード、集積回路、太陽電池、MEMS デバイス、光学デバイスなど、最先端の技術開発や製造プロセスにおいて重要な役割を果たします。

また、次世代のパワー半導体に最適なシリコンカーバイドウエハ (SiC ウエハ) は優れた耐熱性と高い電力効率を誇り、電気自動車、産業用機器など幅広い用途に対応しています。

エクアではお客様のニーズに最適なソリューションを提供いたします。